

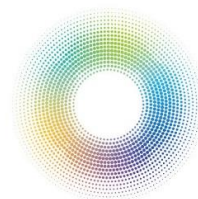
SAMSUNG

삼성전자 DS부문

2026년 하반기 3급 신입사원 채용

당신의 성장이 세상의 혁신으로 이어지는 곳

오늘의 삼성전자 DS부문을 이룬 힘은 새로운 미래를 향한 구성원들의 끝없는 혁신에서 비롯되었습니다. 우리는 개개인의 성장과 발전이 곧 회사의 성장이며 더 나아가 새로운 세상으로 이끄는 힘이라고 확신합니다. 당신이 가슴 뛰는 일을 찾을 수 있는 곳, 당신의 상상이 혁신의 씨앗이 되는 곳, 서로를 존중하며 그 속에서 더 큰 성장을 이뤄내는 곳, 삼성전자 DS부문에서 당신의 내일을 만들어 보세요.



당신의 성장이
세상의 혁신으로
이어지는 곳
삼성전자 반도체

Job Description

삼성전자 DS부문

2026년 하반기 3급 신입사원 채용공고

사업부	직무	모집전공	근무지
메모리 사업부	반도체공정설계	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	화성, 평택
	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	화성, 평택, 천안, 온양
S.LSI 사업부	회로설계	전기전자(HW), 이공기타	화성
Foundry 사업부	회로설계	전기전자(HW), 재료/금속, 전산/컴퓨터, 이공기타	기흥
	반도체공정설계	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 전산/컴퓨터, 이공기타	기흥, 화성
CTO_반도체 연구소	반도체공정설계	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	기흥, 화성, 평택
	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	기흥, 화성, 평택
TSP총괄	평가및분석	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 산공, 수학, 통계(이공), 이공기타	천안, 온양
	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	천안, 온양
	안전보건	환경/안전, 화학/화공, 이공기타	천안, 온양
AX/PI센터	신호및시스템설계	산공, 전산/컴퓨터, 전기전자(HW), 기계, 물리, 수학, 통계(이공), 이공기타	기흥, 화성, 수원, 평택



메모리 사업부

최첨단 기술을 이용한 DRAM/NAND/Solution 개발을 통해
세상의 모든 Data를 담을 수 있는 세계 최고의 메모리 회사



Job Description

메모리사업부 (Memory Business)

- 직무 : 반도체공정설계
- 근무지 : 경기도 화성, 평택

메모리 반도체 제품의 모든 공정 프로세스를 설계하고,
제품의 성능, 특성 및 품질 확보를 위한 최적의 소자/Layout/Mask를 개발하는 직무

Role

• 공정 프로세스 설계

- 최적 공정 조건 개발 및 소자의 물리적 특성 설계
- 제품 요구 성능과 품질, 양산성을 확보하기 위한 공정 설계 및 구현
- 취약 공정 개선을 통한 안정적 수율 확보 및 공정 최적화
- 소자/공정 특성을 활용한 양산 제품 검증

• 소자 개발 및 특성 분석

- 제품 요구 성능과 품질을 확보하기 위한 소자 설계
- 제품 양산성 확보를 위한 소자 특성 및 신뢰성 향상 방안 연구
- 시뮬레이션을 이용한 소자 특성 예측 및 불량 분석
- 분석 장비와 통계적/물리적 분석 방법을 활용한 소자특성 분석
- 소자 Core 기술 개발

• Layout Architecture

- 회로설계를 기반으로 한 제품 공정별 최적 Layout 및 Mask 설계
- 최적화된 Pattern구현을 위해 Mask 기획부터 출고까지의 프로세스 수립/추진
- Mask 제작 관련 내/외부 고객의 요구사항 분석 및 개선
- 차세대 공정개발에서 발생할 위험요인을 감소시키기 위한 Mask 변경점 관리

• 수율 향상 및 불량 분석

- 양산 제품의 공정 프로세스 결정 및 제품 생산의 기준 제시
- 공정 기술 조건, 제품 특성, 원가, 수율 등 제품개발/생산활동 제반 연구
- 제품 신뢰성 및 품질 분석(WF & PKG Level)
- 불량 분석 방법론 개발 및 데이터 분석 시스템 개발

Job Description

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자기학, 반도체소자, 반도체공학, 기초전자회로 등

• 재료/금속

반도체 재료 및 소자, 재료공학개론, 결정구조, 재료물성 등

• 화학/화공

반도체집적공정, 유기 / 무기 화학, 물리화학 등

• 기계

고체역학, 유체역학, 열역학, 동역학 등

• 물리

반도체물리, 고체의 성질, 양자역학, 전자기학, 플라즈마 기초 등

Requirements

- 반도체 기본 동작원리, 공정개발 등 반도체 개발의 공정프로세스 개선에 필요한 역량 보유자
- 반도체 단위 공정, Device physics 등 반도체 소자 및 공정 관련 전공지식 보유자
- 반도체 소자의 물리적/재료화학적 분석에 필요한 역량 보유자
- 메모리 제품(DRAM, Flash memory 등)의 동작 원리와 구조를 이해하고 제품의 성능, 품질 개선에 필요한 직무 지식 보유자
- 빅데이터 분석 역량 및 통계학 관련 전공지식 보유자

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자(프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- Transistor 관련(물리전자, 고체전자물리) 분석 유경험자
- Data Science 관련 Python, Machine Learning, Big Data, 통계 및 산술/회귀 분석 등 유경험자

Career Vision

- 반도체 제품의 공정 프로세스 설계부터 개선까지의 과정을 거쳐 공정 전반에 아우르는 지식 및 반도체 역량을 배양할 수 있습니다.
- 최적 공정 조건 개발 및 소자 설계를 통해 반도체 소자 전문가로 성장할 수 있습니다.

Job Description

메모리사업부 (Memory Business)

- 직무 : 반도체공정기술
- 근무지 : 경기도 화성, 평택, 충청남도 천안, 온양

반도체 공학 지식을 바탕으로 8대 공정기술, 기반기술을 연구/개발하여 생산성/품질/수율을 향상시키는 직무

Role

• 8대 공정기술 개발 및 생산관리

- 반도체 각 공정기술(Photo, Etch, Clean, CMP, Diffusion, IMP, Metal, CVD)의 개발 및 고도화
- 신제품 양산을 위한 공정 최적화
- 수율/품질 향상을 위한 불량 해결 및 공정 조건 표준화
- 공정별 측정된 데이터의 정기 모니터링을 통한 생산 관리 및 품질 관리

• Defect(불량)개선 Engineering

- 사고 예방 체계에 따른 Defect 사고 예방
- 선행 수율 예측 및 수율/품질 핵심 Defect 발굴
- 구조적, 물리/화학적 특성 분석 기반 Defect 발생원인 규명 및 개선
- Defect 기인 수율/품질 분석 방법론 및 데이터 분석 시스템 개발

• 공정 기반기술 연구

- 계측 공정 개선을 통한 측정 결과 신뢰성 향상
- 소자 구조 및 계면반응 분석으로 제품 개발 및 품질 향상
- 양산 소재/품질 성능 개선 및 고도화를 통한 공정 안정성 확보
- 공정 한계 극복을 위한 차세대 소재 확보, 생산성 향상 및 효율 극대화
- 차세대 분석기술 확보(신규 분석법 개발, Simulation 기법 등)

Job Description

• 공정/설비 문제 분석 및 자동화 시스템 구현

- 분석 Tool을 활용한 공정/설비 문제 원인 분석 및 해결
- 빅데이터 분석을 활용한 공정/설비 자동화 시스템 구축 및 최적화

• 검사(Inspection)·계측(Metrology)기술 개발 및 생산 관리

- 측정된 검사, 계측 데이터 모니터링을 통한 품질 관리, 항상성 유지관리
- 제품 모니터링을 위한 검사, 계측 기술 개발 및 고도화
- 신제품 양산을 위한 검사, 계측 조건 최적화 및 생산성 향상

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

반도체소자, 전자기학, 반도체집적공정, 기초전자회로 등

• 재료/금속

반도체공정, 재료공학개론, 재료물리화학, 재료물성 등

• 화학/화공

반도체공정, 유기/무기화학, 물리화학 등

• 기계

고체역학, 메카트로닉스, 열역학, 동역학, 정역학, 유체역학 등

• 물리

반도체물리, 고체물리, 양자역학, 전자기학, 플라스마 기초 등

Job Description

Requirements

- 반도체 기본 동작원리, 공정개발 등 반도체 개발의 공정기술 개선에 필요한 역량 보유자
- 반도체 소자의 물리적/재료화학적 분석에 필요한 역량 보유자
- 빅데이터 분석 역량 보유자
- 배치 부서 및 업무에 따라 교대근무(변형교대) 수행 가능한 자

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자(프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- Big Data의 통계적 Tool 활용 가능자(R, Python 등)

Career Vision

- 공정 엔지니어로서 공정 전반의 연구 및 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다.
- 공정 최적화와 품질 개선 활동을 통해 공정 전문가로 성장할 수 있습니다.

Job Description

S.LSI사업부 (S.LSI Business)

- 직무 : 회로설계
- 근무지 : 경기도 화성

시스템 반도체 (AP, Modem, Image/Automotive Sensor, PMIC, DDI, Security, RFIC 등)를 개발하기 위한 Analog/Digital 회로를 설계, 검증하고, 고객에게 솔루션을 제공하는 직무

Role

• Analog 회로설계

- 시스템 반도체 제품 (SoC, RFIC, DDI, PMIC, Security, Sensor 등) 특성에 맞는 Analog IP 개발 및 제품 적용
- ADC, Amplifier, Regulator, DC-DC, Antenna 등 저전력/초고속 Analog 회로설계
- 고속 신호 전송을 위한 I/O회로, Physical Layer, SI/PI 연구 개발

• Digital 회로설계

- 제품별 특화 Digital IP 설계 (CPU, GPU, 5G Modem, Wi-Fi, BT, GNSS, Video, Audio, ISP, Security 등)
- AI 전용 NPU 설계 (고성능 저전력 NPU Core 설계 및 Modeling)
- Mobile, Automotive SoC 회로 설계 (RTL Design, Integration, and Simulation)
- Image Sensor, DDI, PMIC Logic 설계
- 제품별 기능 구현 및 분석/평가를 위한 FPGA 설계
- System Architecture (Bandwidth, Power, Scenario) 최적화
- SoC DFT 아키텍처 및 관련 IP 설계
- SOC Reference HW platform 개발 (Board level)

• 설계/검증 방법론 개발 및 Layout 설계

- 설계기술 개발 및 검증 방법론 연구, 설계 자동화 Solution 개발
- Physical Layout 설계

Job Description

• 회로 검증 및 솔루션 제공

- 설계 과정의 회로 검증, 불량 분석 및 최적화 방안 연구
- 제품별 요구 사항 및 실제 사용 환경(온도, 위치, 전기적 특성)에서의 동작 및 효율성 검증
- H/W Security Attack / Defense 기술 개발 및 보안 인증
- 고객 사용 Tool 개발 및 기술 지원

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자기학, 회로이론, 논리설계, 컴퓨터 구조, 디지털 전자회로, 아날로그 전자회로, 디지털 시스템 설계 및 실험, 디지털 신호처리, 프로그래밍, 확률 및 랜덤프로세스 등

Requirements

- Analog 및 Digital 회로설계를 이해하고 분석 가능한 자
- 프로그래밍 언어 (Verilog/C 등) 구현 가능한 자
- 회로 개발 Tool (Oscilloscope, Spectrum Analyzer, Signal Generator, Cadence, Ansys 등) 역량 보유자

Pluses

- 전자회로의 구성 및 동작원리를 이해하고, 관련 프로젝트 수행 경험 보유자
- Verilog를 사용한 H/W Design 프로젝트 수행 경험 보유자
- 해외 고객 지원을 위한 외국어(영어, 중국어) 회화 역량 보유자

Career Vision

- SOC(Exynos), DDI, PMIC, Sensor 등 다양한 시스템 반도체 제품의 회로설계 및 Layout설계 경험을 통해 최고의 설계 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 4차 산업혁명의 핵심인 AI 반도체를 직접 설계하고, 상용화에 참여함을 통해 최고의 시스템반도체 설계 전문가로의 역량을 키울 수 있습니다.



Foundry사업부

세상의 모든 혁신 안에 Samsung Foundry를!
We Fabricate your Success on Silicon



Job Description

Foundry사업부 (Foundry Business)

- 직무 : 회로설계
- 근무지 : 경기도 기흥

시스템 반도체에 필요한 다양한 Analog/Digital IP를 개발하고, 최고 수준의 반도체 회로 설계, 검증 역량을 통해 Foundry 고객에게 최적의 설계 솔루션을 제공하는 직무

Role

• Foundation Library IP 개발

- TR/Bitcell 기반의 Standard Cell, SRAM, NVM, GPIO 등 핵심 Foundation IP 게이트 레벨 회로 설계 및 최적화
- DTCO 및 ESD 솔루션을 통한 공정 한계 극복 및 칩의 PPA 극대화 구현
- HPC, Mobile, Auto 등 애플리케이션별 최적화 Cell Library와 Seamless Design Kit 및 맞춤형 솔루션 개발
- 고속, 저전력 Custom SRAM 및 차세대 NVM 설계, ESD Device/PDK 개발을 통한 글로벌 표준 Library 생태계 구축

• 반도체 Analog IP 개발

- HPC, AI, 5G, Automotive 등 차세대 제품향 초미세 공정 Analog IP 설계 (Data Converter(ADC/DAC), Ultra-low jitter PLL, High-efficiency Power Management IP, High-Accuracy Temperature Sensor, Droop Detector, Analog Front End)
- 고객 제품 특화된 Custom Analog IP 설계
- 고성능 SerDes를 위한 Key Analog IP 설계
- 신 공정 선행 개발 및 분석을 통한 Analog/RF Design Infra 개발

• 반도체 High-Speed Interface IP 개발

- HPC/AI 및 Network향 초고속 D2D, 56G/112G/224G Interface IP
- 5G Modem 및 고속 Storage향 PCIe, UFS Interface IP
- LPDDR, GDDR, HBM Interface IP
- Mixed-Signal Circuit 설계

Job Description

• 반도체 Security IP 개발

- Mobile/Modem/Automotive/IoT/SSD Controller향 핵심 Security IP 개발
- TRNG/PUF/Attack Detector IP 개발
- Post-Quantum Cryptography Accelerator, Memory Protection IP 개발

• IP Silicon Validation

- 설계된 회로의 electrical 특성 적합도 평가
- Product level 호환성 평가
- 측정 환경 자동화 및 분석 기법 개발
- 최신 공정 기반 설계 평가 및 개선 방법론 (성능 평가 Test Chip 분석)

• IP Firmware 개발

- IP 구동을 위한 firmware 개발
- 다양한 실장 환경에 동작하도록 만드는 adaptation algorithm 개발

• IP Custom Layout Design 개발

- Analog/Interface IP Layout
- Physical Verification
- Data Preparation & Reticle Solution

• Foundry ECO 협업 및 인프라 개선 업무 (SAFE IP)

- IP Portfolio 중장기 전략 수립 및 Market Trend 분석 업무
- Foundry promotion을 위한 해외홍보 및 IP vendor사와 Partnership 강화를 위한 Technical/Business workshop 운영
- 도입 IP 관련 일정 관리, sign-off 조건 가이드 및 당사 설계 인프라 사용 관련 Technical support
- IP Design Quality 이슈 분석, 해결 및 재발 방지 방법론 구축
- AI 활용한 Design Automation 및 Design 검증 Flow 혁신
- 공정-설계 간 협업 촉진 역할 수행 및 공정 경쟁력 Monitoring Circuit 개발
- Analog-Digital Design Guide Document 발행 및 Technical support

• 신규 공정 개발을 위한 DTCO 및 Test Chip 개발

- 신규 공정/DTCO 검증 및 개선용 2D/3D Test Chip 제작
- 신규 공정 DFT 설계 방법론 및 불량 해석 Solution 개발
- 신규 공정 경쟁력을 위한 DTCO 수행: 공정 특화 합성/P&R 개발로 PPA 목표 달성
- 고객 Design 기반 PPA 최적화

Job Description

• 반도체 설계 방법론 연구 및 설계 인프라 개발

- 반도체 공정 기반 PDK(Process Design Kit) 개발 및 유지보수
- DRC / LVS / Pcell / PEX 등 물리 검증(Physical Verification) 룰셋 개발
- SPICE Model, Device Model 기반 시뮬레이션 환경 구축 및 검증
- 공정 변경 사항 반영을 위한 PDK 버전 관리 및 릴리즈
- PDK life-cycle 관리 system 개발
- EDA 툴(Cadence, Synopsys, Siemens EDA 등) 기반 PDK 호환성 검증 및 검증 방법론, 검증 환경 개발
- 고객사 또는 설계자 대상 PDK 사용성 개선 및 기술 지원
- Digital 설계를 위한 EDA Enablement 및 Design Methodology 구축
- Analog 설계 자동화를 위한 EDA Enablement 및 Design Methodology 구축
- AI/HPC/Auto Application 특화 Design Methodology 구축
- 3DIC/2.5D 특화 EDA Enablement 및 Design Methodology 구축
- AI를 활용한 Design Intelligence 구축 및 설계 자동화를 위한 In-house S/W 개발

• SOC Design Service and Support

- Foundry 고객향 공정 최적화된 Chip 설계 개발 및 양산 리딩
- RTL-to-GDS 설계부터 Si. Bring-up/Validation까지 full turnkey SoC 개발
- Chip Architecture, RTL design, and SOC integration
- Clock/Power/System/Peri./High-speed IP subsystem Design
- SOC Design Function 검증 및 성능 검증
- DFT Architecture and Design (Scan, Memory BIST, JTAG and the advanced DFT schemes) 및 Si. Test bring-up (Wafer/Package Test)
- Physical Implementation & Design including SDC, Synthesis, Low power, Floorplan, Auto PnR(Place, Clock Tree Synthesis, Route), Timing sign-off, and Physical verification.
- ML Based Physical Design, PPA(Power Performance Area) 최적화, 2.5D/3D Design Platform,
- On/Off-chip Power Integrity(PI), Signal Integrity(SI), System-level (chip/package/board) PI/SI 솔루션. HPC/AI향 고성능/대면적 PSI 솔루션
- BootROM, Embedded OS 지원, Device driver/firmware 개발 및 Silicon function validation
- 양산용 System level hardware platform 개발 및 System Level Test 지원

Job Description

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자기학, 회로이론, 논리설계, 논리회로, 디지털 전자회로, 아날로그 집적회로, 반도체공학전자기학, 전자기학, 물리전자, 신호 및 시스템, 공학수학, 디지털 시스템 설계 및 실험, 디지털 신호처리의 기초, 멀티미디어 공학개론, 확률 및 랜덤프로세스 등

• 재료/금속

고체물리학, 광학, 전자재료공정 및 설계, 광전자공학, 전자재료물성 및 설계

• 전산/컴퓨터

컴퓨터공학개론, 기초프로그래밍, 객체지향 프로그래밍, 자료구조, 디지털논리회로 및 실험, 소프트웨어 검증, 기계학습, 인공지능

Requirements

- 회로설계 관련 지식을 보유하고 이해/분석할 수 있는 역량을 갖춘 자
- 프로그래밍 언어 (Verilog, C, C++, Python, Perl, Tcl 등) 구현 가능한 자
- 반도체 설계/분석을 위한 EDA(Electronic Design Automation) 환경 역량 보유자 (Synopsys/ Siemens/ Cadence/ CST 등)
- 원인 분석 및 해결 능력 보유자
- 반도체 소자 및 공정에 대한 이해 가능한 자
- 해외 파트너와 협업을 위한 어학 능력 보유자

Pluses

- Analog 및 Digital 회로설계를 이해하고 분석 가능한 자
- 직무와 연관된 경험 보유자 (프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- Verilog를 사용한 H/W Design 프로젝트 수행 경험 보유자
- 반도체 공정 수업 또는 회로설계/소자 시뮬레이션 경험

Career Vision

- 선단 공정 Design Methodology 및 Library/PDK 개발 역량을 보유한 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 전 세계 글로벌 고객과 협업하여 고객사 제품에 특화된 전용 회로 설계 및 Digital/Analog IP 설계 역량을 보유한 전문가로 성장할 수 있습니다.

Job Description

Foundry사업부 (Foundry Business)

- 직무 : 반도체공정설계
- 근무지 : 경기도 기흥,화성

고객이 요구하는 Chip의 Spec을 충족시키기 위하여 반도체 공정 아키텍처를 설계하고, 공정 및 제품에 적합한 소자를 개발하며, 수율 향상을 위해 제품 양산 관리 및 공정을 최적화하는 직무

Role

• Process Integration

- 다양한 고객의 요구 Spec에 부합하는 Customized 공정 설계 및 검증
- 모듈 공정 설계, Baseline 공정 및 파생 공정 확보
- 양산화 공정 균일성 확보 및 변동성 관리
- 양산 제품의 공정 프로세스 결정 및 제품 생산 기준 확보
- 취약 공정 개선을 통한 안정적 수율 확보 및 공정 최적화
- 소자/공정 특성을 활용한 양산 제품 검증

• 소자 개발(Device/SRAM)

- 다양한 제품에 적합한 소자 설계 및 구현 (SPICE/ TCAD simulation & modeling)
- Customized 공정에 따른 소자 특성 분석 및 성능 최적화
- SRAM 특성 분석 및 최적화
- 개발 life-cycle에 따른 성능 개선, 양산성 및 산포 개선을 통한 양산성 확보
- 성능 개선 item 도출 및 평가 검증

• Device/SRAM 분석 및 성능 특성 개선

- 개발 life-cycle에 따른 성능 개선, 양산성 및 산포 개선을 통한 양산성 확보
- 공정, 설계 및 제품 특성을 이해하고 적합한 소자 특성 구현 및 최적화
- 성능 개선 item 도출 및 평가 검증

Job Description

• Logic제품을 위한 최신 공정 설계

- Mobile AP(Application Processor), AI향 Server용 CPU, GPU 등의 제품 개발을 위한 최첨단 선단 노드 공정 개발 (EUV기반 3nm이하 GAA 공정)
- Automotive향 제품을 위한 공정 개발 및 양산성 확보
- 차세대 HBM(High Bandwidth Memory) 구현을 위한 Base Die 공정 개발
- IoT, Connectivity, Network Router용 RF(Radio Frequency) 제품을 위한 공정 개발
- HPC용(High Performance Computing) Si Photonics 특화 공정 개발

• LSI제품을 위한 특화 공정 설계

- 차세대 eNVM(embedded Non-Volatile Memory) 및 FD-SOI 공정 개발
- eFlash(SIM, FSID, NFC) 제품을 위한 공정 개발
- IoT(MCU+RF) 제품을 위한 공정 개발
- DDI(Display Driver IC) 제품을 위한 공정 개발
- PMIC(Power Management IC) 제품을 위한 공정 개발
- CIS(CMOS Image Sensor) 제품을 위한 공정 개발
- WBG(Wide Band Gap, GaN) 화합물 반도체 공정 개발

• 수율 향상 및 제품 운영

- 수율, 원가, 제품 특성 등 개발 및 생산 활동 전반 연구
- 통계 및 빅데이터, Smart factory System 개발 및 FAB data 분석
- Systematic/Random 불량 발생 Modeling 및 수율 개선 knob 발굴
- 제품별 Mask, Route 및 계측 Guide 구축과 관리

Job Description

Recommended Subject

- 전기전자(HW)

전자기학, 반도체소자, 반도체공학, 기초전자회로 등

- 재료/금속

반도체 재료 및 소자, 재료공학개론, 결정구조, 재료물성 등

- 화학/화공

반도체집적공정, 유기 / 무기 화학, 물리화학 등

- 기계

고체역학, 유체역학, 열역학, 진동학, 동역학 등

- 물리

반도체물리, 고체의 성질, 양자역학, 전자기학, 플라즈마 기초 등

- 전산/컴퓨터

수학, 통계학, 빅데이터, 지능형소프트웨어학 등

Requirements

- 기본적인 반도체 공정과 소자 특성에 대한 역량 보유자
- 공학계열(전기전자, 재료/금속, 화공, 기계 등), 물리, 화학계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 기본 동작원리, 공정개발 등 반도체 개발의 공정프로세스 개선에 필요한 역량 보유자
- 반도체 소자의 물리적/재료 화학적 분석에 필요한 역량 보유자
- Foundry 제품(AP, modem, Auto/HPC 등)의 동작 원리와 구조를 이해하고, 제품의 성능, 품질 개선에 필요한 직무 지식 보유자

Job Description

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자 (프로젝트 · 논문 · 특허 · 경진대회)
- Data Science 관련 Machine Learning · Big Data · 컴퓨터공학 · 통계 등 경험 및 지식 보유자
- Python/C#/C/C++/Visual Basic/Java Script 등 프로그래밍 경험 보유자
- AI 자격증 또는 관련 프로젝트 경험자
- 고객과 기술적인 소통이 가능한 어학 역량 보유자

Career Vision

- 시스템 반도체의 선단 공정 개발 역량을 키울 수 있습니다.
- 공정과 제품에 적합한 소자를 설계하고 구현하는 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 반도체 수율 향상 및 불량 분석 등을 연구 및 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다



CTO_반도체연구소

미래 반도체 기술의 패러다임을 선도하는 세계 유일의 종합 반도체 연구소



Job Description

CTO_반도체연구소(Semiconductor R&D Center)

- 직무 : 반도체공정설계
- 근무지 : 경기도 기흥, 화성, 평택

차세대 소자/공정/Package연구와 공정 설계를 통해 첨단 반도체 제품을 개발하는 직무

Role

- **Process Integration**
 - 메모리 반도체(DRAM, Flash 등), 시스템 반도체(Logic, CIS 등) 개발
 - 차세대 메모리/Logic/CIS/Package 등 Architecture/Structure/Integration 연구
 - 제품별 Line Data를 활용한 수율 예측 및 개선 방안 도출
- **Device Analysis**
 - Transistor, Cell Design 등 차세대 반도체 제품 소자 개발
 - 반도체 소자의 특성 예측, 측정, 데이터 분석을 통한 소자 특성 개선
 - 소자 동작 모델링 및 불량 분석을 통한 성능 및 수율 개선
- **Package Design**
 - 메모리 반도체, 시스템 반도체 제품향 고집적, 고성능 Package 구조 개발

Job Description

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자회로, 전자기학, Device physics, VLSI design 등

• 재료/금속

재료공학원리, 재료물리화학, 재료공학개론, 분자전자재료, 재료물성 등

• 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

• 기계

고체역학, 열역학, 정역학, 동역학, 유체역학, 기계 진동학 등

• 물리

전자기학, 양자역학, 광학, 고체물리학, 반도체물리, 플라즈마물리학 등

Requirements

- 전기전자, 재료, 물성, 화학, 회로, 소자 및 물리 등 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 단위 공정 이해, 회로 및 소자 특성, 물성 및 화학 분석 원리, 전기전자 재료 특성 및 물성 등 반도체 공정 관련 경험자, 빅데이터 활용 역량 보유자

Pluses

- 컴퓨터 프로그래밍 언어를 통한 개발, 데이터 분석 및 시뮬레이션 역량/경험 보유자
- 직무와 연관된 논문 작성 및 특허 출원 이력 보유자
- 해외 연구소/설비, 소재 협력사와 커뮤니케이션 가능한 수준의 외국어 회화 역량 보유자

Career Vision

- 반도체 제품 개발 전반을 경험하여 반도체 소자 및 차세대 Package 개발을 주도하는 역량을 배양할 수 있습니다.
- 각 소자별 선행 기술과 차세대 Package 기술에 대한 연구/개발을 통해 반도체의 미래 기술 전문가로 성장할 수 있습니다.

Job Description

CTO_반도체연구소(Semiconductor R&D Center)

- 직무 : 반도체공정기술
- 근무지 : 경기도 기흥, 화성, 평택

차세대 공정/소재/Package/Photomask를 연구하여 첨단 반도체의 공정 최적화를 구현하는 직무

Role

• 공정개발

- 제품 개발을 위한 반도체 8대 선행 공정 기술 확보 및 고도화
- 신물질 및 신개념 차세대 반도체 소자 구현을 위한 차세대 공정 기술 개발
- Module별 계측 Data 모니터링을 통한 공정관리
- 개발 방법론 및 프로세스 개선을 위한 요소기술 개발
- 차세대 Package 기술 확보 및 소재 개발

• 계측기술

- Optic & E-beam등을 이용한 Defect Inspection 기술 개발
- Module별 계측 기술 개발 및 Defect 환경 영향성 분석

• 분석기술

- TEM/SEM 기반의 미세 구조 분석 기술 확보 및 솔루션 제공
- 표면분석 기술을 활용한 박막의 화학적 조성·결합 상태 분석

• 소재기술

- 패터닝/Chemical/CMP/Precursor 소재 개발
- 화학 물질 디자인, 분석 및 결과 해석
- 소재 성능 예측 및 소재 품질 관리

Job Description

Recommended Subject

- 전기전자(HW)

전자회로, 전자기학, Device physics, VLSI design 등

- 재료/금속

재료공학원리, 재료물리화학, 재료공학개론, 분자전자재료, 재료물성 등

- 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

- 기계

고체역학, 열역학, 정역학, 동역학, 유체역학, 기계 진동학 등

- 물리

전자기학, 양자역학, 광학, 고체물리학, 반도체물리, 플라즈마물리학 등

Requirements

- 전기전자, 재료, 물성, 화학, 회로, 소자 및 물리 등 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 단위 공정 이해, 회로 및 소자 특성, 물성 및 화학 분석 원리, 전기전자 재료 특성 및 물성 등 반도체 공정 관련 경험자, 빅데이터 활용 역량 보유자

Pluses

- 컴퓨터 프로그래밍 언어를 통한 개발, 데이터 분석 및 시뮬레이션 역량/경험 보유자
- 직무와 연관된 논문 작성 및 특허 출원 이력 보유자
- 해외 연구소/설비, 소재 협력사와 커뮤니케이션 가능한 수준의 외국어 회화 역량 보유자

Career Vision

- 반도체 8대 공정 및 차세대 Package의 선행 개발 경험을 통해 미래 공정을 선도하는 최고 공정 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 소재, 설비, 시뮬레이션 등 반도체 공정기술과 관련된 여러 분야와의 협업을 통해 저변을 넓힐 수 있습니다.



TSP총괄

반도체 가치를 극대화하는 패키지의 힘!



Job Description

TSP 총괄 (Test and System PKG)

- 직무 : 평가및분석
- 근무지 : 충청남도 천안, 온양

Package 불량 발생 시, 발생 원인을 분석하여 재발 방지 방안을 수립하고,
반도체 공정 설비와 계측기, 소재 원류 측면 확보된 Data에서 발생하는 Big Data를 활용하여
이상점 감지를 통해 불량 발생을 사전에 예측하여 수율을 향상시키는 직무
[주요 제품] Conventional Package 제품: Mobile/Graphic DRAM, NAND Flash, SSD 등
Advanced Package 제품: HBM, FoWLP, 2.xD 등

Role

• Package 제품 품질 Risk 분석

- 설계/소재/공정 개발 단계 품질 Risk 사전 검증
- 제품 Design Rule 개선 및 공정 마진 평가
- 신제품 신뢰성 평가 및 분석

• 양산 품질 개선

- 공정 변경점 및 산포 관리를 통해 품질 위험요소 관리/개선
- 품질 Data 분류, Grouping 및 빅데이터 통계적 기법 활용을 통한 유효 인자 감지
- 공정 모니터링을 위한 통계적 샘플 계측 방법 제시
- 품질 시스템 구축 및 시스템 개선

• 수율 개선 및 불량 분석

- 제품 양산성 관리 및 수율 개선
- 반도체 Package의 비파괴/파괴(전기적/물리적) 분석을 진행하여 불량의 원인 분석
- 제품 설계, 공정, 고객의 관점에서 특성을 평가하여 불량 원인 규명
- 분석한 제품/공정/소재 불량의 원인에 대한 Solution 도출 및 개선사항 관리
- Big Data 분석 및 통계 모델링을 통한 불량 예측 및 예방

• 계측기술 개발

- 공정 결과 자동 측정을 위한 계측설비 개발
- 자동화 공정 계측(Measurement)&검사(Inspection) 기술 개발 및 개선 연구

Job Description

• Package 소재 입고 품질 관리

- 반도체 Package용 유기/무기/고분자 소재 개발 및 양산 소재의 품질 관리 (Film, EMC, Metal, Substrate, Capacitor 등)
- 소재사 CoA(Certificate of Analysis) data 분석 및 항목 최적화
- 소재사 변경점 및 CoA 산포 관리를 통한 위험요소 관리/개선
- 불량 원인 및 소재사 R/M/F Parameter에 대한 동질성 분석 (R : Raw Material, M : Process Monitoring, F : Final Product)

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자회로, 회로이론, 전기전자회로, 디지털시스템설계 및 실험, 논리회로, 컴퓨터프로그래밍, 컴퓨터구조, 데이터 구조 및 알고리즘, 신호 및 시스템, 디지털 신호처리, Microwave/RF Engineering, 데이터구조 등

• 재료/금속

금속재료, 반도체공정, 재료공학, 재료과학, 결정학, 고분자재료분석, 반도체소자, 신소재종합설계, 철강재료 등

• 화학/화공

고분자공학, 고분자화학, 공업분석화학, 공업유기화학, 열전달, 재료공정공학, 전기화학공학, 나노소재화학, 물리화학 등

• 기계

열역학, 유체역학, 고체역학, 열전달, 동역학, 기계공학실험, CAE, 재료공학, 기계진동학, 공학수치해석, 기구학, 기계요소설계, 센서 개론, 설계 제작 실습, 메카트로닉스 등

• 물리

고체물리, 반도체물리, 전자물리의 기초, 양자역학, 물리화학, 전산물리, 통계물리 등

• 산업공학

데이터마이닝, 데이터분석, 통계응용 등

• 수학/통계

확률개념 및 응용, 수리통계, 수치해석, 선형대수학, 데이터분석, 이산자료분석 등

Job Description

Requirements

- 공학계열(전기전자, 재료/금속, 화공, 기계, 산업공학 등), 물리, 화학, 수학/통계 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 FAB공정, PKG 조립공정, Test공정 등 반도체 공정기술 지식 보유자
- 다양한 분석장비(SEM, FTIR, RAMAN, IC, XPS 등)의 사용 경험 및 활용이 가능한 자
- 소재개발/품질관리 경험 및 지식 보유자
- 프로그래밍 언어(C/C++/Verilog, Java, R, Python 등) 및 알고리즘 문제 해결 역량 보유자

Pluses

- 품질 직무에 대한 기본적인 지식 보유자
(품질 공학, 환경안전, PL(Product Liability), SPC, 생산관리, Test Engineering, Big Data 해석)
- 반도체 Package 및 품질 직무와 연관된 대내외 활동 경험 보유자
- 반도체 Package공정 및 품질 관련 졸업논문 및 국내/외 저널 논문 보유자
- 기계적/열특성 분석, 성분 분석 등 다양한 분야의 분석 지식/경험 보유자
- 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 활용한 프로젝트 수행 경험 보유자
- 반도체 소재 개발 및 품질 관련 직무와 연관된 대내외 활동 경험 보유자
- 해외 소재사와 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 일본어) 회화 능력 보유자

Career Vision

- 패키징 제품의 공정 모니터링, 수율, 품질 등 전체 프로세스 관리 및 Data 분석, 패키징 심화 분석 역량을 배양할 수 있습니다.
- 반도체 산업에서 패키징 Process에 대한 높은 이해도를 가질 수 있으며, 향후 Process Integration, Quality Management, Data Scientist, Defect Analyst 등 다양한 분야의 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 신 제품/소재/공정 개발 검증, 양산 품질 관리, 품질경영시스템, 제품 신뢰성 평가 및 고객 대응 기능 역량을 배양할 수 있습니다.
- 다양한 제품의 평가, Big 데이터 분석, 통계적 양산 관리, Audit 경험을 통해 패키징 관련 품질 전문가로 성장할 수 있습니다.

Job Description

TSP 총괄 (Test and System PKG)

- 직무 : 반도체공정기술
- 근무지 : 충청남도 천안, 온양

반도체 관련 지식을 바탕으로 Package조립 공정, Test공정의 연구/개발을 통해 Package 제품 양산 과정의 불량률을 개선하고 생산성을 높이는 직무(공정)
 [주요 제품] Conventional Package 제품: Mobile/Graphic DRAM, NAND Flash, SSD 등
 Advanced Package 제품: HBM, FoWLP, 2.xD 등

Role

• Package 양산 공정 개선 및 생산성 향상

- PKG 조립 공정(Back-Lap, Saw, Die Attach, Wire Bonding, Flip Chip Mount, CoW Bonding, Mold, Marking, Solder Ball Attach, Saw&Sorter, SSD/Module SMT)별 불량률 개선 및 생산성 향상 기술/설비 개발
- 양산 제품의 품질/수율 향상을 위한 불량 분석/개선 및 공정 조건 표준화
- 공정별 데이터 분석을 통한 양산 Process 최적화 및 품질 관리/개선

• Test Process Design

- Package제품의 불량 검출과 대책 수립을 위한 테스트 기술 개발
- Test공정(MBT, Test, MVP) 불량률 개선 및 생산성 향상, Tester 설비 개발
- 연구, 개발, 양산, 출하 각 단계에서 발생하는 결함을 모니터링 및 스크린
- 고객사별 요구에 맞춘 기능 지원 및 품질 기준 확보를 위한 평가 및 검증
- 가속화 Factor를 이용한 사전 분석을 통해 잠재적 불량 분석

• 공정 기반기술 연구

- Test/계측 Data 분석을 통한 불량 예방 및 측정 Data 신뢰성 향상
- 자동화 기반 공정 계측, 검사 기술 개발 및 개선 연구
- 공정에서 발생하는 불량 원인에 대한 물리적/화학적 메커니즘 수립 및 개선 연구
- 양산 소재 품질 관리 및 사용 공정 최적화를 통한 생산성 향상 및 효율 극대화
- 공정 효율개선, 소재 변경/개선을 통한 제조원가 개선
- 설비 H/W Platform 표준화를 통한 설비 호환성/Flexibility 확보
- 공정 효율 개선을 위한 시스템 설계 및 개발

Job Description

• 공정설비 개조개선 및 신규 설비 개발

- 양산 Data를 활용한 공정 최적화, 이상점 분석/개선, 자동화 시스템 구축
- 데이터 분석을 활용한 공정/설비 자동화 시스템 구축 및 최적화
- 설비 핵심 Unit 및 요소기술 진단/평가
- 공정 결과의 자동 측정을 위한 계측 설비 개발
- 신규 공정 양산 대응을 위한 설비 개발

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

반도체공학, 반도체소자, 전자회로, 전자기학, 반도체집적공정, 기초전자회로, 논리설계 및 실험, 회로이론, 디지털 논리설계, 영상처리 등

• 재료/금속

반도체공정, 금속재료, 재료공학개론, 재료물리화학, 재료물성, 고분자전자재료, 복합재료, 물리화학, 소결공학 등

• 화학/화공

반도체공정, 유기/무기화학, 물리화학, 열전달, 이동론, 고분자화학, 전기화학공학, 공정제어, 반응공학, 화공열역학, 화공유체역학 등

• 기계

열전달, 열역학, 유체역학, 고체역학, 공학재료학, 기계진동, 기계공학실험, 수치해석, 전산유체역학, 계측공학, CAE, 열유체설계, 기계요소설계, 전산제도(설계/CAD프로그램) 광학공학, 메카트로닉스 등

• 물리

고체물리, 반도체물리, 전자기학, 열물리, 양자역학, 플라스마 기초, 물리화학 등

Job Description

Requirements

- 공학계열(전기전자, 재료/금속, 화공, 기계 등), 물리, 화학 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 PKG조립 공정, 계측공정, Test공정 등 반도체 공정과 기술 관련 지식 보유자

Pluses

- 반도체 Package 공정 및 품질 관련 경험 보유자(프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- 반도체 개발 관련 Tool 역량 보유자
- 데이터 분석 역량 보유자
- 광학계 구조 및 이론 이해, Image 분석 역량 보유자
- 해외 업체와 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 일본어) 회화 역량 보유자

Career Vision

- 세계 반도체 시장의 핵심 경쟁력인 패키징 각 공정의 공법, 공정 조건 개발 업무 능력 배양을 통해 Process Integration, Process Developer 전문가로 성장할 수 있습니다.
- Package 제품의 Wafer, Package, Test Process 품질/생산성 향상 업무 및 공정 기반기술 연구 역량을 배양할 수 있습니다.
- 발전하는 차세대 반도체 공정 연구/분석/개선 직무 경험을 바탕으로 Package 공정기술 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 반도체 테스트 엔지니어로 테스트 프로그램 작성, 인터페이스 개발을 진행하며, 신제품 Test Solution을 제공할 수 있습니다.
- 공정/출하 시 발생하는 주요 불량인자들에 대해 분석하고 해결책을 적용하여 개선 할 수 있습니다.
- 반도체 설비의 컨셉 설계, 요소기술 개발, 설비 시스템 S/W, 통신 등 설비 표준화 플랫폼 개발의 전문가로 성장할 수 있습니다.

Job Description

TSP 총괄 (Test and System PKG)

- 직무 : 안전보건
- 근무지 : 충청남도 천안, 온양

안전보건, 방재, 인허가 및 인증, 현장 위험 작업 감리 등 각 분야 법규 준수를 위한 반도체/인프라 현장 맞춤 기준 수립 및 사고 예방 활동 수행 (안전보건분야 관리 및 지원 직무)

Role

• 안전보건

- 안전관리 : 안전진단 및 불합리 개선 지원, 법규 이행 점검 및 위반사항 개선
- 공정안전 : PSM(공정안전보고서) 등 반도체 공정 내 시스템적 안전관리 구축 및 개선 활동
- 위험성평가 : 반도체 산업 특화 위험성평가 Tool 개발, 정량적 Risk Assessment
- 안전문화 : 자율 안전보건 활동을 통한 안전문화 정착 및 안전보건교육
- 유해인자 관리 : 물리/화학/생물학적 유해인자 관리 및 안전한 작업환경 구축
- 건강증진 : 임직원 건강증진, 감염병 예방 활동 추진 및 건강검진, 의료기관 운영 관리

• 소방방재

- 방재 기준 : 반도체 생산 환경에 적합한 선진 방재 기준 수립 및 복합재난상황 대응
- 소방시설 운영 : 소방시설 구축 및 운영, 소방 법규 준수를 위한 인허가 및 규제 대응
- 비상상황 대응 : 누출, 화재, 재난 등 대응능력 향상 프로그램 운영

• 기타

- 정부·공공기관 인허가 및 점검 대응 (고용노동부, 안전보건공단 등)
- 환경안전 인증 취득 및 유지를 통한 ESG 활동 (ISO, 녹색기업 등)
- EHS관련 데이터 관리, 분석, 예측/진단 모델 개발, 서비스 운영

Job Description

Recommended Subject

• 환경

환경공학, 대기관리, 수질관리, 폐자원순환관리 등

• 안전보건

안전공학, 건설/전기/기계/소방안전, 위생/인간공학, 보건학 등

• 화학/화공

화학공학, 반도체집적공정, 유기/무기화학, 물리화학, 환경/안전화학공학 등

Requirements

- 환경, 에너지, 지속경영, 안전보건, 소방 관련 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 설비, 공정 안전 관련 지식 및 예측 기술 보유자(Simulation, 평가 Tool 활용)
- 기술력 기반 법규 해석 능력 보유자
- 반도체 사업장의 특성과 환경안전의 중요성을 이해하고 생명존중과 책임감을 가진 자로서 환경안전 분야 전공자 및 역량 보유자

Pluses

- 안전보건 직무 관련 국가기술자격 보유자 (기사 이상)
- 안전보건 직무 관련 대내외 경험 보유자 (프로젝트, 논문, 특허, 경진대회 등)
- AI 및 Machine Learning에 대한 이해와 활용 경험 보유자
- 해외 법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 중국어) 회화 역량 보유자
- 프로젝트 현장 안전보건 관련 Setup업무 경험 보유자
- 반도체 현장에 대한 Clean Room 구조 및 Utility 공급, 순환 시설에 대한 이해 및 경험자
- 산업심리/행동심리 관련 전공자 및 역량 보유자

Career Vision

- 반도체/인프라 현장 맞춤 기준 수립 및 사고 예방 활동 수행으로 현장 맞춤 안전보건 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 안전보건 분야 법규를 반영한 사내 기준 수립 및 관리를 통해 안전보건 전문가로 성장할 수 있습니다.



AX/PI센터

반도체 비즈니스의 글로벌 경쟁력 제고를 위한
AI & IT 기술과 서비스를 제공하는 CAIO 조직



Job Description

AX/PI센터 (AX/PI Center)

- 직무 : 신호및시스템설계
- 근무지 : 경기도 기흥, 화성, 수원, 평택

Data 및 신기술(AI, ML 등)을 바탕으로 DS 부문의 IT 인프라/서비스 설계 및 개발을 통해 Autonomous Factory 구축을 목표로 연구 개발하는 직무

Role

- Autonomous Factory 설계/구축
 - Autonomous Factory 향 Manufacturing Execution System 설계
 - 안정적인 시스템 유지를 위한 SRE(Site Reliability Engineering)
 - 설비/공정 품질 및 수율/품질 개선을 위한 시스템 설계
 - 검사/계측, 설비 환경 Data 분석 및 차세대 Data Pipeline 솔루션 설계
 - Safety 환경안전 & Smart Infra 시스템 설계 및 고도화
 - 가상 FAB Modeling & Simulation 통한 FAB Capa 및 실시간 이상 감지 설계
 - 업무 프로세스 기반 시스템 통합 설계 및 개발
- Digital Twin 기반의 Automation System 기획/구축/운영
 - DS부문 국내/외 제조라인 자동화 기획/설계
 - Autonomous Factory 향 반송/로봇 Platform 구축
 - 반도체 FAB 변동성 고려 설비 배치 및 AHMS 최적 설계 Modeling
 - 안정적인 물류 제어 시스템 유지를 위한 SRE(Site Reliability Engineering)
 - 물류 Capa 검증 및 분석, 물류 Simulation을 통한 반송 최적화
 - 생산 환경 변화를 위한 물류 반송/저장 System 기획/설계
 - 반송/로봇 설비 이상감지진단 및 품질 관리

Job Description

• Data Governance & Data/DevOps/Knowledge/IAM Platform 기획/구축/운영

- AI/ML/DL 모델을 활용한 서비스, 검색, 챗봇, Q&A 등 사내 서비스 인프라 기획/구축/운영
- 학습용 Data 전처리 및 Data Pipeline 기획/구축/운영
- Data 유통 시스템 (Data Publish/Data Movement/Data Catalog/DIMS) 구축 운영
- DevOps/협업 Tool 구축/운영 및 Build/CI/CD 인프라 기획/구축/운영
- Data Platform/Data Lake/DW 및 Data IT Infra 설계/구축/운영
- Self-Analytics 도구, 데이터 병렬 분산 처리 도구 및 DBaaS 기획/구축/운영
- 개념/논리 Data Modeling 및 대용량 Data Processing System 기획/구축/운영
- IAM(Identity Access Management, 계정/인증/권한) 체계 구성 및 운영 관리
- Data Governance(운영/보안/메타데이터/표준화/품질/기준정보) 및 System 기획/구축/운영
- Data Governance/Engineering & AI Ready Data
- BI Tool 및 데이터 쿼리 서비스 엔진 개발/운영
- RAG 기반 서비스 개발, 지식 모델링 및 검색 엔진 개선

• Enterprise IT Infrastructure for AI & HPC 설계/구축/운영

- Server, Storage, Network Infra 설계, 구축 및 운영
- 고전력/고효율의 AI향 Data Center 설계 및 구축
- Computing Architecture 연구 및 개발
- Enterprise Network 설계 및 구축, 모니터링 체계 구현
- Cloud(Public/Private/Hybrid) Enterprise Architecture 설계
- Kubernetes 기반 Enterprise Cloud 설계, 구축 및 운영
- MES(Manufacturing Execution System) Cloud 설계, 구축 및 운영
- AI(Artificial intelligence) 및 HPC(High Performance Computing) Infra 설계, 구축 및 운영
- AI 및 HPC Workload의 성능 분석 및 HW/SW Co-Optimization

• MIS(Management Information System) 기획/구축/운영

- DS부문의 엔지니어링 업무 혁신을 위한 시스템 기획/구축/운영 (Business Intelligence)
- R&D, 건설/인프라, 제조지원(설비 관리 등) 등 핵심 비즈니스 도메인 별 시스템 기획 및 IT 전략 수립
- 업무 프로세스 취약점 진단, 컨설팅 (PI. Process Innovation) 및 프로젝트 (SI. System Integration) 추진/관리 (PMO)
- IT Solution 및 Platform 활용한 MIS 영역 EA (Enterprise Architecture, BA/DA/AA/TA) 분석/설계 및 구축
- MIS Application/Architecture 및 HW/SW 관리/운영/개선/최적화 (SM. System Management)
- AI/LLM, Web/Mobile 등의 IT 기술을 활용한 Digital Transformation 및 업무 자동화

Job Description

Recommended Subject

- **산업공학**

데이터관리와 분석, 프로그래밍언어, 실험계획법, 정보산업공학, SCM, 경영과학, 경영전략, 프로젝트관리, 품질경영, 경영정보시스템 등

- **전산/컴퓨터**

컴퓨터구조, 프로그래밍언어, 컴퓨터프로그래밍, 소프트웨어공학, 알고리즘, 운영체제, 데이터분석, 데이터마이닝, 머신러닝, AI, 빅데이터 등

- **전기전자(HW)**

통신이론, 네트워크 설계, 데이터구조, 프로그래밍 등

- **기계**

진동학, 동역학, 기계제품설계, 시스템제어이론, 기계설계학, 기계시스템 설계, 열역학, 열전달, 유체역학, 공조/냉동 등

- **물리**

전자계측 및 실습, 전산물리 등

- **수학/통계**

확률 개념 및 응용, 공업수학, 데이터마이닝, 통계분석, 회귀분석, 선형대수학 등

Job Description

Requirements

- 데이터 분석 및 통신 방식을 이해하고 신기술에 대한 관심과 이해도를 보유한 자
- 시스템 요구사항을 이해하고 이에 맞는 소프트웨어 및 IT인프라 기획/설계가 가능한 자
- 컴퓨터, 전기전자/통신, 수학/통계/산업공학, 물리/기계 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공 지식 보유자

Pluses

- 프로그래밍 언어(C/C++/C#/Python/Java 등) 및 알고리즘 문제 해결 역량 보유자
- 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 활용한 프로젝트 수행 경험 보유자
- 보안관리 및 거버넌스, 통신보안, 표준화 데이터베이스, 인터넷보안 관련 경험 보유자
- 해외 법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 중국어) 회화 역량 보유자
- 운영체제(Windows/Linux) 및 Embedded시스템, ARM Architecture역량 보유자
- 직무와 연관된 경험 보유자(프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)

Career Vision

- IT 인프라/서비스 설계 및 개발을 통해 Autonomous Factory 분야 전문가로 성장할 수 있습니다.
- Data 및 신기술(AI, ML 등)을 바탕으로 연구 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다.